

**中国科学院半导体研究所**

**青年科技人才推进计划**

**实施方案**

申请人才推进计划档位： [ ]  A档 [ ]  B档

项目属性：[ ] 前沿基础研究 [ ] 应用基础研究 [ ] 关键技术研究

购置类型：[ ] 设备 [ ]  软件 [ ]  机时

设备/软件/机时名称：

项目名称：

项目负责人：

资助经费： 电话：

所属部门：

电子邮件：

**中国科学院半导体研究所制**

2022年3月28日

一、基本信息

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人信息 | 姓名 |  | 性别 |  | 出生年月 |  |
| 学位 |  | 职 称 |  |
| 电话 |  | 手 机 |  |
| 主要研究领域 |  |
| 电 子 邮 箱 |  |
| 实验室 |  |
| 课题组 |  |
| 科研仪器/软件/机时基本信息 | 中文名称 |  |
| 英文名称（如有） |  |
| 规格型号/类型 |  |
| 生产厂商/服务方 |  |
| 产地国别/地点 |  |
| 主要功能/服务内容 |  |
| 总价/万元 |  |
| 经费预算 | 研究所资助金额：返还研究所金额：自筹经费金额： |

**二、科学属性说明（**[ ] **前沿基础** [ ] **应用基础** [ ] **关键技术）**（限500字）

|  |
| --- |
|  |

**三、设备/软件/机时购置必要性**（限500字）

|  |
| --- |
|  |

**四、未来工作设想**（限500字）

|  |
| --- |
|  |

**五、预期产出**（限500字）

|  |
| --- |
|  |

**六、研究基础及配套条件**（限500字）

**七、设备/软件/机时配置和报价情况**

|  |
| --- |
|  |

**八、有关单位签章**

|  |
| --- |
| **项目负责人承诺：** 我保证内容的真实性。如果获得资助，我将切实保证研究工作时间，认真开展工作，按时报送有关材料，确保项目任务书中的指标按期或提前完成。若填报失实和违反规定，本人将承担全部责任。项目负责人（签字）：年 月 日 |
| **实验室或课题组负责人承诺：**项目批准后，­­­­ （课题组）承诺自愿按要求按时返还所购设备费用中研究所资助部分的20%用于研究所发展的后续自有经费。若违反本规定，视为主动放弃资助资格。课题组负责人（签字）：年 月 日 |
| **推荐部门意见：**同意推荐­­­­ 申请研究所青年科技人才推进计划项目。推荐部门负责人（签字）：年 月 日 |
| **科研处意见：**科研处负责人（签字）：年 月 日 |
| **所领导意见：**单位负责人（签字）：年 月 日 |